

フリップチップ実装の内部応力評価

福岡大学共同開発 SIPOS-TEG IP0304_**

【背景】

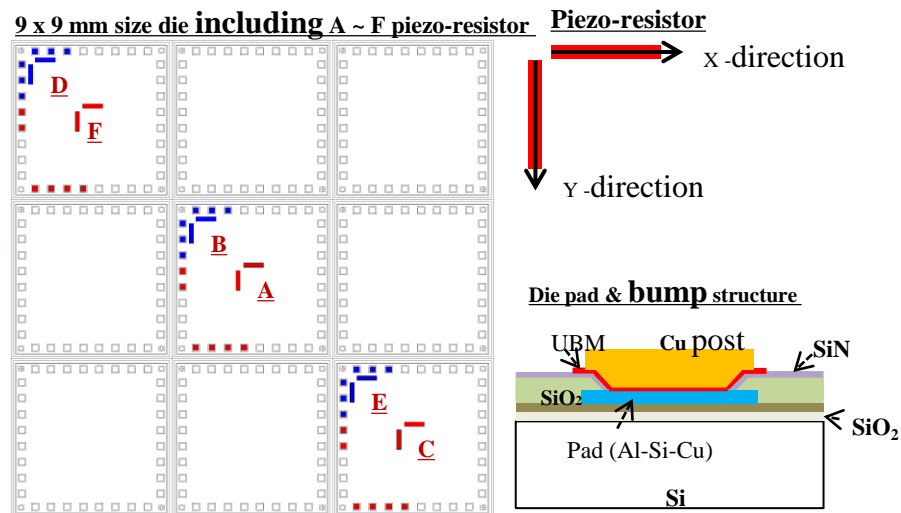
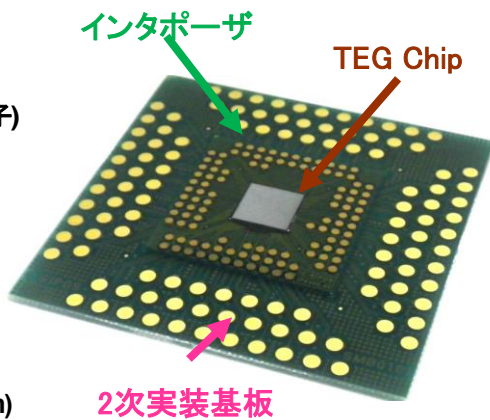
三次元パッケージに適用される薄いLSIのフリップチップ実装など、PKGの薄型化により、PKG内部応力が信頼性、LSI特性に与える影響が懸念されている。三次元半導体研究センター及び福岡大学・半導体実装研究所では、様々な材料を用いた評価基板の作製、LSIの実装、TEGチップを用いたPKG内部応力の評価をトータルで行なっている。

★TEGを用いた応力評価例

フリップチップ応力評価インタポーザ

(有機コアバージョン)

- 1.基板構成: 1-2-1ビルドアップ基板
- 2.基板サイズ: 30mm × 30mm × t0.37mm
- 3.層構成
 - ・Layer1: ABF表面配線(Chip搭載面、測定端子)
 - ・Layer2: コア上面配線(THランド、Viaランド)
 - ・Layer3: コア下面配線(THランド、Viaランド)
 - ・Layer4: ABF裏面配線(測定端子)
 - ・SR1, SR2: 表裏ソルダーレジストパターン
 - ・TH: コア基板スルーホール
 - ・Via1: Layer1レーザーVia
 - ・Via2: Layer4レーザーVia
- 4.端子表面処理: 無電解Ni/Auめっき
- 5.FC接続Padサイズ: Φ170um(SR開口Φ120um)
- 6.測定端子サイズ: Φ1.5mm(SR開口Φ1.2mm)
- 7.測定端子数: 108端子
- 8.搭載Chip: STAC-TEG 3×3 (9.0mm角)



* 表示したピエゾ抵抗を測定

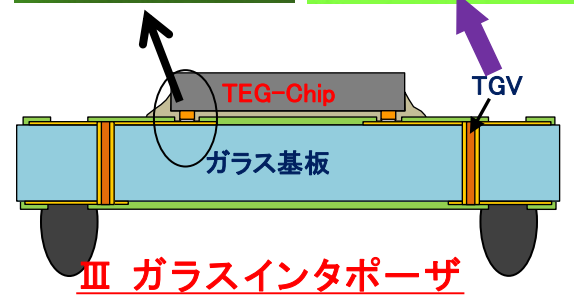
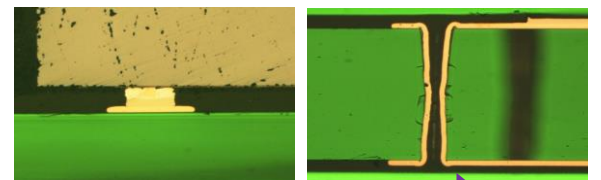
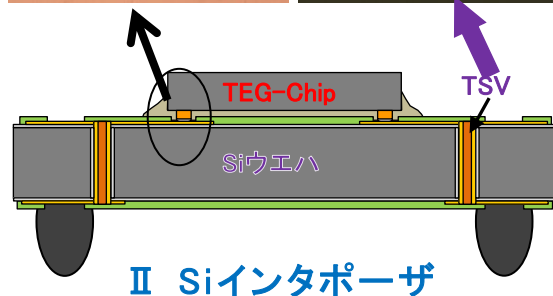
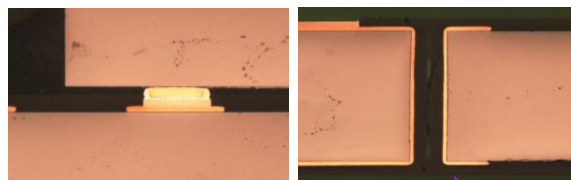
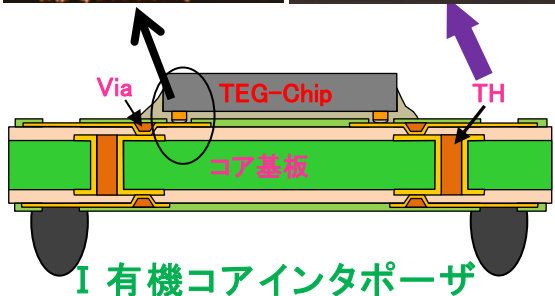
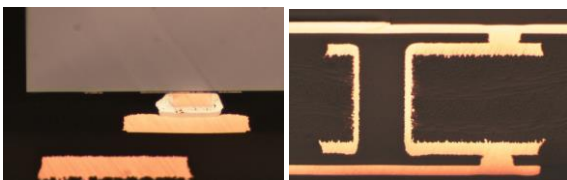
応力評価チップSTAC-TEG詳細

株式会社WALTS社ご提供

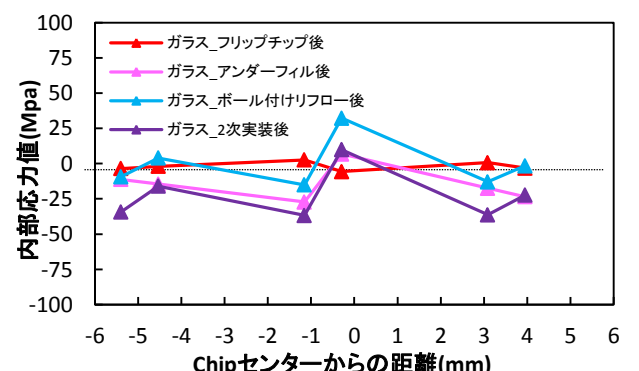
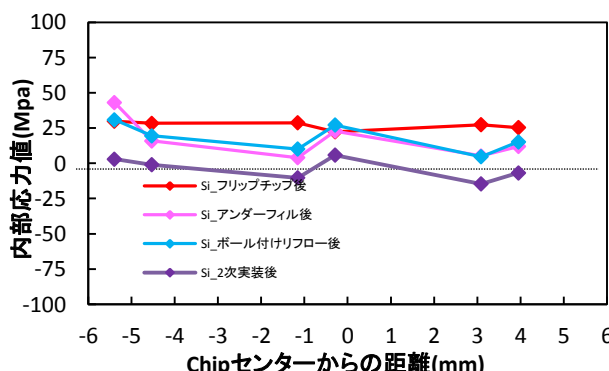
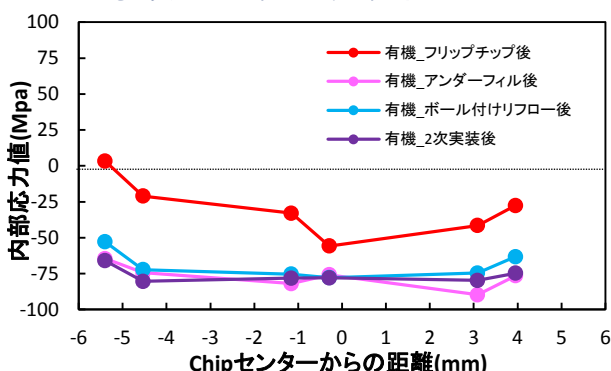
SIPOS-TEG IP0301_BUS

フリップチップ実装応力評価パターン

【評価構造例】



【応力測定結果例】



インタポーザ構成材料により内部応力に大きな差があることが判る